

有机硅增粘剂 SK-AP02

产品特性:

- 显著提升加成型硅胶对 PPA、PET、PCBA、镀银等材质的粘接；
- 含“氢”反应型。

技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	无色透明液体	目测
运动粘度 (mm ² /s@25°C)	10~100	GB/T 10247-2008
折光率 (25°C)	1.44~1.46	GB/T 6488
含氢量 (wt%)	0.20~0.36	HG/T 4804-2015

典型应用:

- 电子灌封胶：加成型导热阻燃灌封胶的选择性粘接；
- 压敏胶：提升加成型压敏胶对基材的锚固；
- LED 封装硅胶：促进硅胶对镀银层和 PPA 的粘接。

使用方法:

- 添加至含氢组份，添加量为硅胶总量的 1~2%；
- 建议 100°C 以上固化硅胶，固化时间视具体应用而定。

包装贮运:

- SK-AP02 按 5KG/桶，20KG/箱包装；
- 建议 0~8°C 控温存放。通常短时间的室温存放也可，但不建议超过 1 个月；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
- 自生产日期起，3 个月内使用最佳，超期复检合格后方可使用。

安全与环保:

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。